

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム (SenTePack)

第1回総会・研究会 プログラム

- 1、開催日時：2026年6月19日(金) 13:00~16:55
- 2、開催方式：会場/Online (ハイブリッド開催)
- 3、開催会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11階 第1会議室
- 4、会場アクセス：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>
- 5、プログラム：

13:00~13:30 総会

13:30~13:35 研究会開会挨拶 SenTePack 会長 植村 聖

13:40~14:20 今年度 WG 活動計画

- ・センシング材料 WG
- ・環境モニタリング技術 WG
- ・人・機械インタラクション WG
- ・半導体製造センシング・実装技術 WG

14:20~15:20

講演1「VLAの現状と今後の可能性 海外・国内動向、エコシステム、フィジカル AI におけるセンサーの位置付けと期待」

サイエンスライター 森山 和道 様

- ・概要：視覚・言語・行動を一つのモデルで統合する「VLA」がロボット研究に大きな変化をもたらしはじめている。進展著しい VLA と、活用対象であるヒューマノイドの現在地を俯瞰し、触覚や力覚など新たなモダリティの統合が「フィジカル AI」の能力をどう拡張するかについて考える。そして米中で始まりつつある現場への実装事例やヒューマノイド量産状況を踏まえつつ、今後の日本における研究・社会実装の方向性を展望したい。

15:20~15:50 コーヒーブレイク (名刺交換・意見交換)

15:50~16:50

講演2「生体センシング技術の進化と広がる応用領域」

横浜国立大学 准教授 杉本 千佳 様

- ・概要：生体センシング技術は近年急速に発展し、センサの進化、AI・データ活用、応用の高度化が進んでいる。電磁波、光学センサなど非侵襲・非接触センサによる意識しないセンシング手法、デバイスを感じさせない高感度フレキシブルセンサ、ナノテクノロジーを統合した Lab-on-a-Chip など、応用領域が広がる有望な生体センシングの技術動向を紹介する。

16:50~16:55 研究会閉会挨拶 SenTePack 副会長 山下 健一

お問い合わせ先：

SenTePack 事務局

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシング技術研究部門

e-mail：M-SenTePack-ml@aist.go.jp